

苏州国芯科技股份有限公司

2026年1月30日至2月5日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	景顺长城基金；万家基金；瑞银证券；富达基金；永赢基金；平安资管；盛宇投资；Franchise Capital；财通基金；朴拙资本；观火投研；华泰证券；华福证券。
时间	2026年1月30日；2026年2月2日；2026年2月3日；2026年2月5日
地点	现场交流及线上交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑茫 董事会秘书：龚小刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的汽车电子芯片是否应用了抗量子技术？</p> <p>答：为应对量子技术快速发展对安全所带来的挑战，国芯科技的汽车电子芯片正在积极推进应用抗量子技术。公司最新研发的车规级高端 AI MCU 芯片 CCFC3009PT 应用了抗量子技术，该芯片前瞻性地集成了符合 NIST FIPS 203、FIPS 204 等国际标准的抗量子密码算法，构建了面向量子计算时代的车载安全防护体系，为应对未来量子计算可能带来的安全挑战提供了技术保障。目前该芯片已完成流片正在内部测试中，该芯片面向汽车智能域控、辅助驾驶及跨域融合等高端应用场景，采用多核 RISC-V 架构与专用 NPU 单元协同设计，在算力性能与能效表现上达到行业先进水平。在安全架构方</p>

面，CCFC3009PT 芯片搭载了经过深度优化的硬件安全模块（HSM），显著提升了加解密运算效率与实时响应能力。这一设计强化了芯片在车联网环境下的数据加密、身份认证与通信安全能力，进一步巩固了公司在汽车电子芯片领域的技术壁垒与核心竞争力。目前，公司正积极推进该芯片的后续测试验证与客户导入工作，加速实现国产高端汽车芯片的产业化应用。

2、公司量子安全/抗量子密码产品有哪些？公司在该领域的客户和合作伙伴主要有哪些？目前公司量子安全/抗量子密码产品的应用领域和方向有哪些？

答：公司量子安全/抗量子密码产品主要分两大类，一类是量子安全芯片及模组，另一类是抗量子密码芯片及模组。目前公司推出了系列化的量子安全芯片、模组，包括终端应用量子安全芯片 A5Q、云和服务器应用量子安全芯片 CCP907TQ、终端应用量子安全模组 CCUMU2Q01 和 CCUMU3Q02、云和服务器应用量子安全模组包括量子 Mini PCI-E 密码卡 CCUPM2Q04、量子 PCI-E 密码卡 CCUPH2Q03 和量子 PCI-E 密码卡 CCUPH3Q03。公司的抗量子密码芯片、模组产品包括抗量子密码卡 CCUPHPQ01，公司与参股公司信大壹密合作推出的抗量子密码芯片 AHC001，以及公司联合中云信安（深圳）科技有限公司设计的支持抗量子密码算法的金融 POS 机应用的 CUni360SQ-ZX 芯片。

公司的量子安全芯片及模组产品已经对外实现批量出货，特别是多款产品已被中电信量子、问天量子、合肥硅臻等量子领域的重要企业采用并已实现销售。公司已为参股公司合肥硅臻提供 QRNG 芯片中光处理芯片的定制设计和量产服务。同时，在量子安全芯片及模组领域，公司已与量子领域的知名企业安徽问天量子科技股份有限公司及公司参股公司合肥硅臻分别组建了量子芯片联合实验室，依托上述两个量子芯片联合实验室，公司与上述合作伙伴在物联网、云计算、先进存储、智能终端等领域，联合开展量子安全芯片的研发和产业化工作。除此之外，公司还与之江数安量子、国腾量子、国信量子、图灵量子等公司签署了战略合作协议。通过上述合作，公司不断推进量子安全芯片迭代升级工作。

公司在抗量子芯片领域通过提供定制化芯片服务也已实现相关

业务收入，并已承接了在关键领域的抗量子芯片联合开发项目。

公司的全资子公司天津国芯科技有限公司与中国移动集团旗下专业芯片设计公司芯昇科技有限公司日前签署了战略合作协议，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，双方将基于各自的技术优势，共同推进量子/抗量子技术以及 RISC-V 技术的应用。面对量子计算对现有公钥密码体系（如 RSA、ECC）构成的颠覆性威胁，国芯科技与西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）正在进行 2025 年度苏州市关键核心攻关项目——“基于 RISC-V 架构的高性能抗量子密码芯片关键技术研发”的研发工作。在抗量子方向，国芯科技还投资了泓格后量子、信大壹密等具有技术先进性的创新型科技企业，并与参股公司信大壹密成功研发抗量子密码芯片 AHC001，推进实现信息安全芯片产品的抗量子化提升。

公司量子/抗量子芯片及模组产品可应用于金融、通信、电力、物联网等领域以及签名/验证服务器、安全网关/防火墙等有高安全要求的信息安全设备中，目前已在电力、通信领域实现出货应用。

公司的发展战略是采用“量子+”的策略，利用量子安全、抗量子密码技术重点进行“云-边-端”及汽车电子自主可控高安全密码芯片体系的“量子化”升级。公司推出的系列化产品，正是这一思路的体现，旨在为金融、通信、电力、物联网、汽车电子等关键行业客户，提供从数据中心到边缘设备的全栈式、可抵御量子计算威胁的密码产品与解决方案，我们将继续沿此路径深化产品研发与市场拓展。

3、目前公司在 AI 领域有哪些具体的技术和产品布局？

答：为顺应 AI 的发展浪潮，公司积极布局 AI NPU 技术研发。在 NPU 领域，公司和香港应科院、龙擎视芯等单位合作面向端/边缘侧应用开展 AI 技术研发，开发 CNN20、CNN100、CNN200 和 CNN300 系列化 NPU IP 核，其中 CNN20 和 CNN100、CNN200 已完成设计验证并可以对外授权，CNN300 正在研发中。公司最新完成研制的神经网络处理器 DPNU 新 IP 产品 CNN200 单核支持 0.5~4.8TOPS 的灵活算力配置，支持算力线性扩展，可以为不同场景提供定制化的 AI 算力解决方案。面向 AI PC 及边缘侧 AI 应用，公司和参股公司龙擎视芯正在合作开发通用神经网络处理器 GPNU IP 核 CNN300，CNN300 以标量

运算单元和矢量运算矩阵相结合，利用专用重构化可编程技术，形成通用可编程形式的人工智能加速体，单核性能将可达 8TOPS，并支持多核堆叠。CNN300 具有多核一致性接口 MLS，支持多个 CNN300 IP 核之间扩展实现更高算力，保障单任务多核情况下数据流的同步和统一，如利用四核堆叠将实现 32TOPS 算力；MLS 接口也支持多颗集成 CNN300 IP 核的 SoC 芯片之间进行数据一致性同步，使得 SoC 芯片能够利用 chiplet 机制实现多核多芯片算力堆叠效果。CNN300 将支持 INT4/INT8/FP16 等常规 AI 应用所需要的数据类型，支持传统的 CNN、RNN 应用，也能支持最新流行的 LLM（大语言模型）应用；相比于传统 ASIC 形式 NPU 加速器，CNN300 具有灵活可重构和高性能高带宽低功耗特点。

以 AI NPU 技术为基础，公司的 AI 业务包含定制 AI 芯片服务业务和自主 AI 芯片业务。

公司自主 AI 芯片业务的主要产品目前主要包括 AI MCU 芯片和正在研发的面向 PC 和边缘侧 AI 应用的高性能算力芯片和模组产品，前述产品主要基于 RISC-V CPU 技术进行研发。

公司 AI MCU 芯片 CCR4001S 目前已在家电的主动感知与节能控制、光伏拉弧检测等场景落地验证，并与生态伙伴联合推出 AI 传感器模组，帮助客户加速量产导入、降低系统成本、缩短开发周期，特别是在智能商用空调领域实现超过 10 万颗的批量出货。公司已完成流片正在内部测试中的公司车规级高性能 RISC-V AI MCU 芯片产品 CCFC3009PT 采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，算力超过 10000DMIPS（6 个运算主核+6 个锁步核，也可以根据用户需要解耦配置主核与锁步核数量），完全依照汽车智能域控场景的需求量身打造。该芯片内部搭载独立 NPU 子系统，可以将虚拟传感器、模型预测通过“硬件加速+工具链适配”的深度整合方案，让开发者可直接沿用成熟的端侧 AI 开发逻辑开展应用设计，大幅降低了车载 AI 功能的开发门槛。

此外，公司和参股公司龙擎视芯正在合作以基于 RISC-V GPNPU 为基础共同打造 PC 和边缘侧高性能 AI 加速芯片。

未来公司将积极拥抱 AI 技术，根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将 AI 技术研究成果积极应用到公司现有

	<p>的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上，持续提升公司汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品的智能化水平，进一步提高公司产品的核心竞争力。</p> <p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月